

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011年5月5日(05.05.2011)



PCT



(10) 国際公開番号

WO 2011/052615 A1

(51) 国際特許分類:

H01R 11/01 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
H01B 5/16 (2006.01) H05K 3/36 (2006.01)

Toshiaki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川
2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社
内 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/069020

(22) 国際出願日: 2010年10月27日(27.10.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2009-248073 2009年10月28日(28.10.2009) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住
友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKE-
LITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区
東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 鍵本 奉広
(KAGIMOTO Tomohiro) [JP/JP]; 〒1400002 東京都
品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークラ
イト株式会社内 Tokyo (JP). 中馬 敏秋(CHUMA

(74) 代理人: 小林 浩, 外(KOBAYASHI Hiroshi et al.);
〒1040028 東京都中央区八重洲二丁目8番7号
福岡ビル9階 阿部・井窪・片山法律事務所
Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.

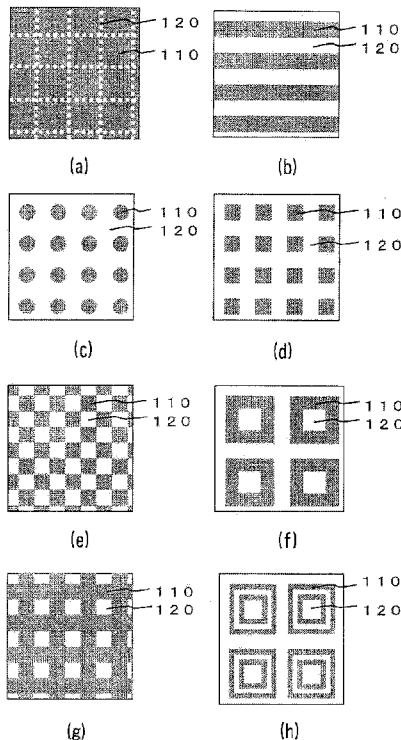
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: CONDUCTIVE CONNECTION MATERIAL AND TERMINAL-TO-TERMINAL CONNECTION METHOD US-
ING SAME

(54) 発明の名称: 導電接続材料及びそれを用いた端子間の接続方法

[図1]



(57) Abstract: Provided is a conductive connection material that has a layered structure comprising a resin composition and a metal foil, said metal foil being either a solder foil or a tin foil. Said conductive connection material is characterized in that the ratio (A/B) between the volume (A) of the resin composition and the volume (B) of the metal foil in the conductive connection material, said metal foil being either a solder foil or a tin foil, is either between 1 and 40 or between 20 and 500. Also provided is a terminal-to-terminal connection method using the provided conductive connection material. The provided conductive connection material is suitable for electrically connecting connection terminals of electronic members in electric or electronic components or the like.

(57) 要約: 本発明は、樹脂組成物と半田箔又は錫箔から選ばれる金属箔とから構成される積層構造を有する導電接続材料であって、前記導電接続材料における樹脂組成物 (A) と半田箔又は錫箔から選ばれる金属箔 (B) との体積比 ((A) / (B)) が 1 ~ 40 又は 20 ~ 500 であることを特徴とする導電接続材料及び該導電接続材料を用いた端子間の接続方法を提供する。本発明の導電接続材料は、電気、電子部品等において電子部材の接続端子間を電氣的に接続するために好適に用いられる。